

羅姆半導體

公司分析報告

ROHM Semiconductor

報告日期：2026年2月11日

代碼：6963.T (東京)

市值：~\$8B

目錄

一、公司概況	2
二、核心產品線	3
三、財務分析	4
四、市場競爭格局	5
五、風險評估	6
六、投資價值	7
七、附錄	8

1.1 基本信息

公司全稱	羅姆半導體集團
英文名稱	ROHM Semiconductor
總部	日本京都
上市地點	東京證券交易所
成立時間	1958年
市值	約\$8B
員工規模	約23,000人

1.2 發展歷程

- 1958年：成立，生產電阻器
- 1967年：開始生產半導體
- 1972年：在東京證券交易所上市
- 2009年：收購OKI半導體
- 2015年：收購SiC襯底供應商SiCrystal
- 2024年：SiC營收突破\$1B

1.3 業務架構

2.1 核心產品

SiC MOSFET	車規級SiC功率器件
SiC襯底	自有SiCrystal襯底產能
IGBT模塊	工業和汽車應用
電源管理IC	PMIC、DC-DC轉換

2.2 終端應用



2.3 技術優勢

- SiC垂直整合：從襯底到器件完全自研
- 日本品質：高可靠性產品
- 功率專長：60年功率器件經驗
- 汽車認證：完整的車規級產品線

3.1 關鍵財務指標

<div>FY2024 營收</div> <div>~¥500B</div> <div>YoY +8%</div>	<div>毛利率</div> <div>~40%</div>	<div>營業利潤率</div> <div>~15%</div>	<div>SiC 營收</div> <div>~\$1B</div> <div>YoY +40%</div>
---	--------------------------------	----------------------------------	--

3.2 季度趨勢

Q4 2024	營收¥130B，SiC需求強勁
Q3 2024	營收¥128B，汽車需求回暖
Q2 2024	營收¥125B，工業需求穩定
Q1 2024	營收¥122B，價格穩定

3.3 業務構成

功率器件	約40%營收
模擬芯片	約25%營收
分立器件	約25%營收
傳感器	約10%營收

4.1 全球地位

日本功率半導體	第4-5位
全球SiC	第4-5位
全球分立器件	第5-6位
日本半導體	第10位左右

4.2 主要競爭對手

英飛凌	全球功率半導體龍頭
意法半導體	SiC競爭對手
安森美	SiC追趕者
瑞薩電子	日本功率芯片競爭者

4.3 競爭優勢

<div> SiC垂直</div> <div>從襯底到器件完全自研</div>	<div> 日本品質</div> <div>高可靠性，車規級認證齊全</div>
---	--

羅姆半導體 - 公司分析報告

2026年2月11日

<div><div></div><div>● 中風險</div><div>規模劣勢</div></div>	<div><div></div><div>● 中風險</div><div>SiC競爭</div></div>	<div><div></div><div>● 低風險</div><div>技術落後</div></div>
<div><div></div><div>● 低風險</div><div>人才流失</div></div>	<div><div></div><div>● 中風險</div><div>價格壓力</div></div>	<div><div></div><div>● 低風險</div><div>匯率風險</div></div>

5.2 關鍵風險分析

- 規模劣勢：營收規模小於英飛凌等競爭對手
- SiC競爭：英飛凌和ST瘋狂擴產
- 汽車周期：日本汽車銷量波動影響
- 日元波動：日元匯率影響出口

5.3 應對措施

- 加速SiC產能擴張
- 拓展海外客戶
- 加強模擬芯片能力
- 控制成本結構

6.1 估值指標

當前市值

~\$8B

PE (TTM)

~15x

PB

~1.5x

股息率

~1.0%

6.2 投資亮點

- **SiC垂直整合**：從襯底到器件完全自研
- **日本品質**：高可靠性產品
- **汽車芯片**：電動車功率器件需求
- **估值便宜**：PE僅15倍

6.3 投資建議

評級：持有

B+

目標價：¥12,000-14,000

邏輯：SiC增長確定，但規模較小

7.1 主要客戶

汽車	豐田、本田、日產、斯巴魯
工業	松下、三菱、歐姆龍
消費電子	索尼、松下、夏普
通信	NTT、KDDI

7.2 生產基地

日本	京都（總部）、福岡
德國	SiCrystal（SiC襯底）
馬來西亞	封裝測試
中國	蘇州封裝測試

7.3 數據來源

<ul style="list-style-type: none">公司年報 (2024)東京證券交易所公告羅姆半導體株式會社報告行業研究報告 (Omdia, Yole)Yahoo Finance 日本市場數據	2026年2月11日
---	------------